

Mille e più ai Competence Days

Numerosi i partecipanti alla due giorni organizzata da Wittmann Battenfeld. Tra le novità la nuova ibrida a due piani e il processo IMIW.

7 maggio 2013 07:32

Si è chiusa con successo l'edizione 2013 dei Competence Days Wittmann Battenfeld, organizzata nella sede della società a Kottlingbrunn, in Austria, all'insegna dello slogan "Power for the Future".



All'evento, che si è tenuto il 24 e 25 aprile scorsi, erano presenti oltre 1.100 stampatori provenienti da tutta Europa, che hanno potuto partecipare a seminari tecnici e toccare con mano le 17 isole di stampaggio in funzione, dotate di periferiche e automazione. L'esposizione è stata allestita nei reparti dello stabilimento austriaco, ampliati di recente per consentire l'assemblaggio di presse di grande tonnellaggio MacroPower.

Il ritorno del costruttore austriaco alle grandi presse è stato segnato dalla presentazione in anteprima della prima ibrida MacroPower E 450/2250, dotata di gruppo di chiusura due piani con servodrive: in particolare, era mostrato un allestimento per lo stampaggio di montanti B per autotive (foto in alto a destra).



I visitatori erano accolti e accompagnati nella loro visita da un robot antropomorfo, per sottolineare il contenuto innovativo proposto dal gruppo Wittmann. Tra le tecnologie mostrate in azione, etichettatura nello stampo con IML e rimozione veloce dei pezzi, iniezione con gas Airmould su una idraulica HM 300, produzione di espansi microcellulari con tecnologia Cellmould, condizionamento variotermico degli stampi

BFMold.

Ma la vera novità della due giorni austriaca era il processo di saldatura dall'interno IMIW (In-Mould Internal Welding) mostrato dal vivo su una pressa EcoPower. L'obiettivo è saldare insieme due pezzi in materiale plastico, creando un guscio che protegge dall'acqua e dall'aria circuiti elettronici o etichette RFID posti al suo interno.

Messo a punto dalla britannica Barkley Plastics e commercializzato in esclusiva da Wittmann Battenfeld, il processo IMIW prevede lo stampaggio simultaneo di due semigusci, l'inserimento dell'etichetta RFID (o altri inserti) in uno dei due pezzi, la traslazione dei semistampi fino a portarli uno di fronte all'altro e la successiva saldatura dall'interno, mediante iniezione dello stesso materiale sulle superfici a contatto (foto a destra).



Si ottiene in questo modo una perfetta adesione sull'intera superficie di contatto e non solo lungo la linea di giunzione, quindi una sigillatura senza formazione del cordone di saldatura.

Â© Polimerica - Riproduzione riservata